



# 4. 技術・新製品開発

## レーザーバリ取り装置

Laser Deflashing System

- ・レーザー光でパッケージ周辺の余分なレジンバリを除去します。
- ・モールドズレを画像認識で位置補正し、高精度加工します。
- ・金型では除去が厳しい微小加工が可能で、また、金型を使用しない為、消耗部品が不要です。



## 大型MAP基板 レーザーマーク装置

Laser Mark System for Large size MAP

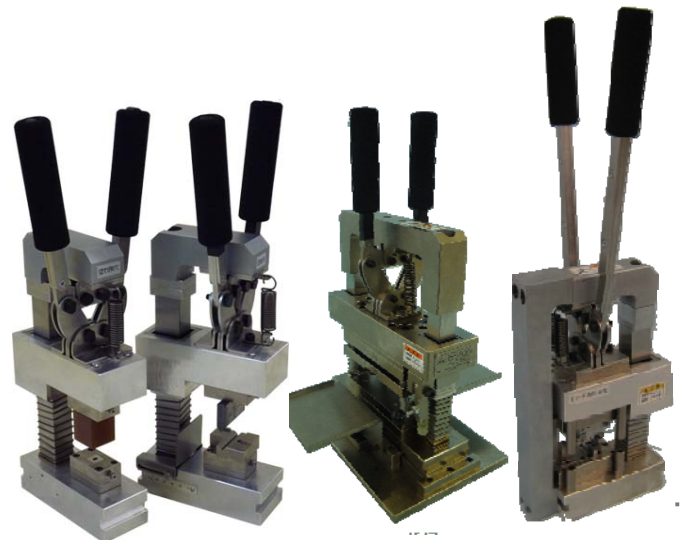
- ・製品搬送ユニットに基板反り矯正機構を持たせ、反りの有る大型MAP基板のマークに最適です。
- ・マークされた製品は静電ブロー&ブラシクリーニングされマーク品質を画像認識で検査します。
- ・リードフレームのマークにも対応します。



## 小型ハンドプレス

Table Top Hand Press

- ・高剛性角ポストを使用したコンパクト低価格なハンドプレスです。
- ・手動加圧で高圧力加工でき、半導体パッケージの個片切断、薄板の打抜き、折り曲げ等の簡易プレス工程に最適です。



## 大型装置 (従来に比べて大型)

- ・半導体分野以外の液晶組立装置や、車載用部品組立装置も製作しています。



お問合せは、本社営業課、東京営業所、または [hsales@i-kk.co.jp](mailto:hsales@i-kk.co.jp) まで。

Contact us at Headquarter sales, Tokyo sales office, or [hsales@i-kk.co.jp](mailto:hsales@i-kk.co.jp) for any inquiry.

## ミニマルパッケージングコア装置（ミニマルシリーズ）

### 〈ミニマルダイボンダ〉

ミニマルサイズを実現した超コンパクトダイボンダ

- ・リアモータ制御によりボンディング機構の小型化と加圧制御の容易化を実現しました。



### 〈ミニマルインクジェットプリンター〉

ソルダーレジストインクをオンデマンド塗布・成膜

- ・ソルダーレジストをインクジェット塗布・成膜させる装置を極限まで小型化して、ミニマルファブ規格のコンパクトな筐体に収めました。
- ・ソルダーレジストインクをオンデマンド塗布・成膜
- ・ソルダーレジストをインクジェット塗布・成膜させる装置を極限まで小型化して、ミニマルファブ規格のコンパクトな筐体に収めました。
- ・ビットマップデータを変更するだけで描画パターンが変更できます。



本資料に関するお問い合わせ



**株式会社 石井工作研究所**  
**ISHII TOOL & ENGINEERING CORP.**

**IR 担 当 者**

TEL : 097-544-1001

E-mail : [tokieda@i-kk.co.jp](mailto:tokieda@i-kk.co.jp)